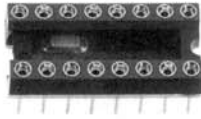


IC-Fassungen

B8370

IC-Fassungen
mit 100-nF-Chip-Keramik-Kondensator



Aufbau

- Präzisionssockel mit integrierter SMD-Leiterplatte zur Breitband-Entkopplung bis 100 MHz
- bis zu zwanzigfache Reduktion der Impedanz im Vergleich zu herkömmlicher Entkopplung
- Impedanz im Frequenzbereich bis 100 MHz unter 10 W

Technische Daten

Isolierkörper:	Thermoplastischer Polyester, glasfaserverstärkt, UL94VO
Entkopplungsplatte:	Glasfaser Epoxyd 0,5 mm dick, Lötstoplack grün, Hot-air verzinkt
Kelchfeder:	SC-4
Material:	Beryllium-Kupfer
Oberfläche:	Kupfer flash Nickel 2-3 µ Gold
Hülse	
Material:	Messing gedreht
Oberfläche:	Kupfer flash, Nickel 2-3 µ Zinn
Kondensator:	Chip-Keramik-Kondensator 0,1 mF ± 20 % Toleranz

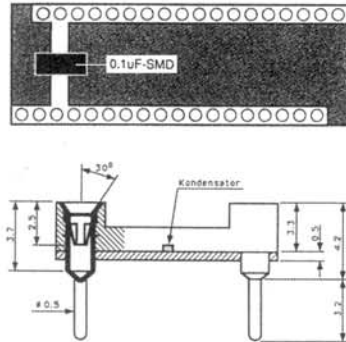
Lieferangaben

Mindestabnahme: siehe Spalte "VkMin" der Preisliste

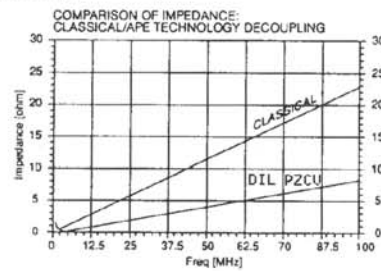
B8370 IC-Fassungen mit 100nF-Chip-Keramik-Kondensator

Artikel	Artikelbezeichnung
DIL14PZCV	IC-Fass.+ Kondensator 14P 7,62mm
DIL16PZCV	IC-Fass.+ Kondensator 16P 7,62mm
DIL20PZCV	IC-Fass.+ Kondensator 20P 7,62mm
DIL24PZCV-S	IC-Fass.+ Kondensator 24P 7,62mm
DIL24PZCV	IC-Fass.+ Kondensator 24P 15,24
DIL28PZCV	IC-Fass.+ Kondensator 28P 15,24
DIL32PZCV	IC-Fass.+ Kondensator 32P 15,24
DIL40PZCV	IC-Fass.+ Kondensator 40P 15,24

DIL_PZCV

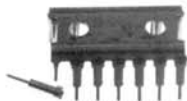


Impedanz-Vergleichsdiagramm



B8390

Carrier-IC-Präzisionsfassungen



Technische Daten

Kontaktstift:	Messing, verzinkt
Kontaktfeder:	BeCu, ca. 0,25 µ Au über Zinn
passend für:	Rundstift 0,40 bis 0,56 mm Vierkantstift 0,25 x 0,45 mm

Lieferangaben

Mindestabnahme: siehe Spalte "VkMin" der Preisliste

B8390 Carrier-IC-Präzisionsfassungen

Artikel	Artikelbezeichnung
DIL06CA	Ca-IC-Fass. 6pol RM=7,62mm
DIL08CA	Ca-IC-Fass. 8pol RM=7,62mm
DIL14CA	Ca-IC-Fass. 14pol RM=7,62mm
DIL16CA	Ca-IC-Fass. 16pol RM=7,62mm
DIL18CA	Ca-IC-Fass. 18pol RM=7,62mm
DIL20CA	Ca-IC-Fass. 20pol RM=7,62mm
DIL24CA	Ca-IC-Fass. 24pol RM=15,24mm
DIL28CA	Ca-IC-Fass. 28pol RM=15,24mm
DIL40CA	Ca-IC-Fass. 40pol RM=15,24mm

DIL_CA

